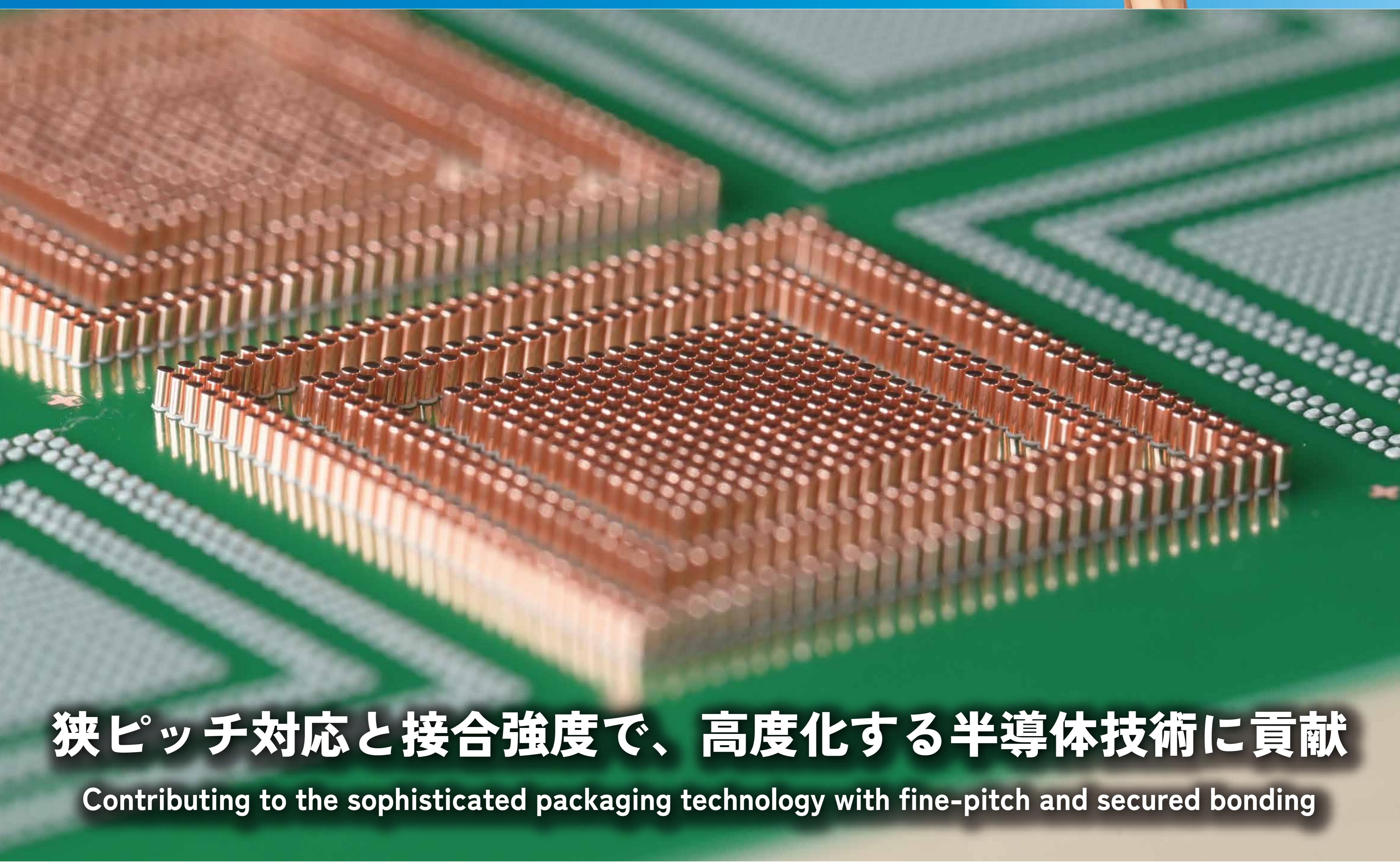


Cu ピラー搭載装置

Cu Pillar Mounting Machine



狭ピッチ対応と接合強度で、高度化する半導体技術に貢献

Contributing to the sophisticated packaging technology with fine-pitch and secured bonding

FOWLP や POP 構造などの 3D パッケージに必要となる Cu ポストのプロセス技術
カイジョーが高精度のマウントソリューションを提供いたします

Cu post process technology required for 3D packaging such as FOWLP and POP

KAIJO provides high-precision mounting solutions

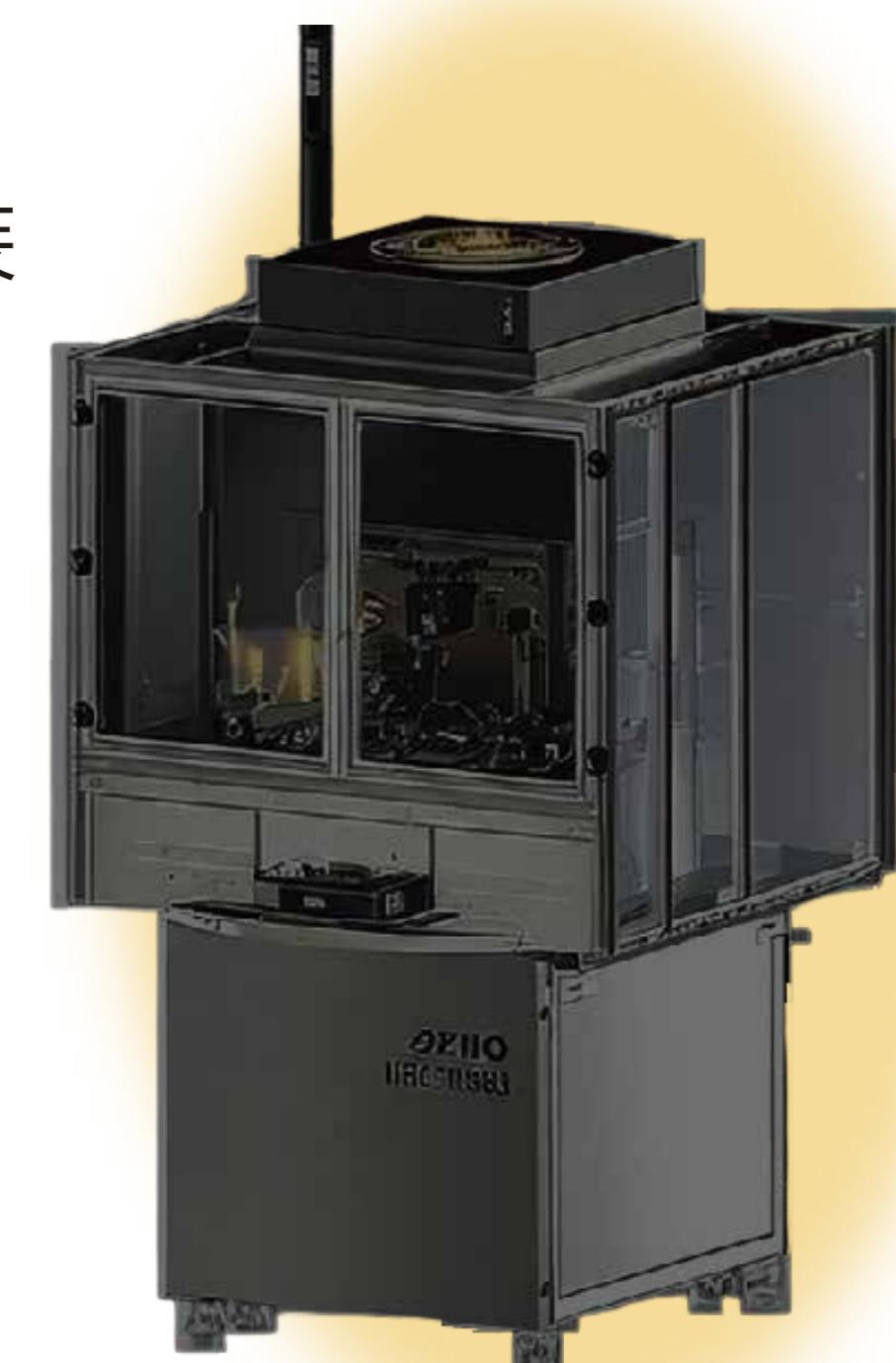
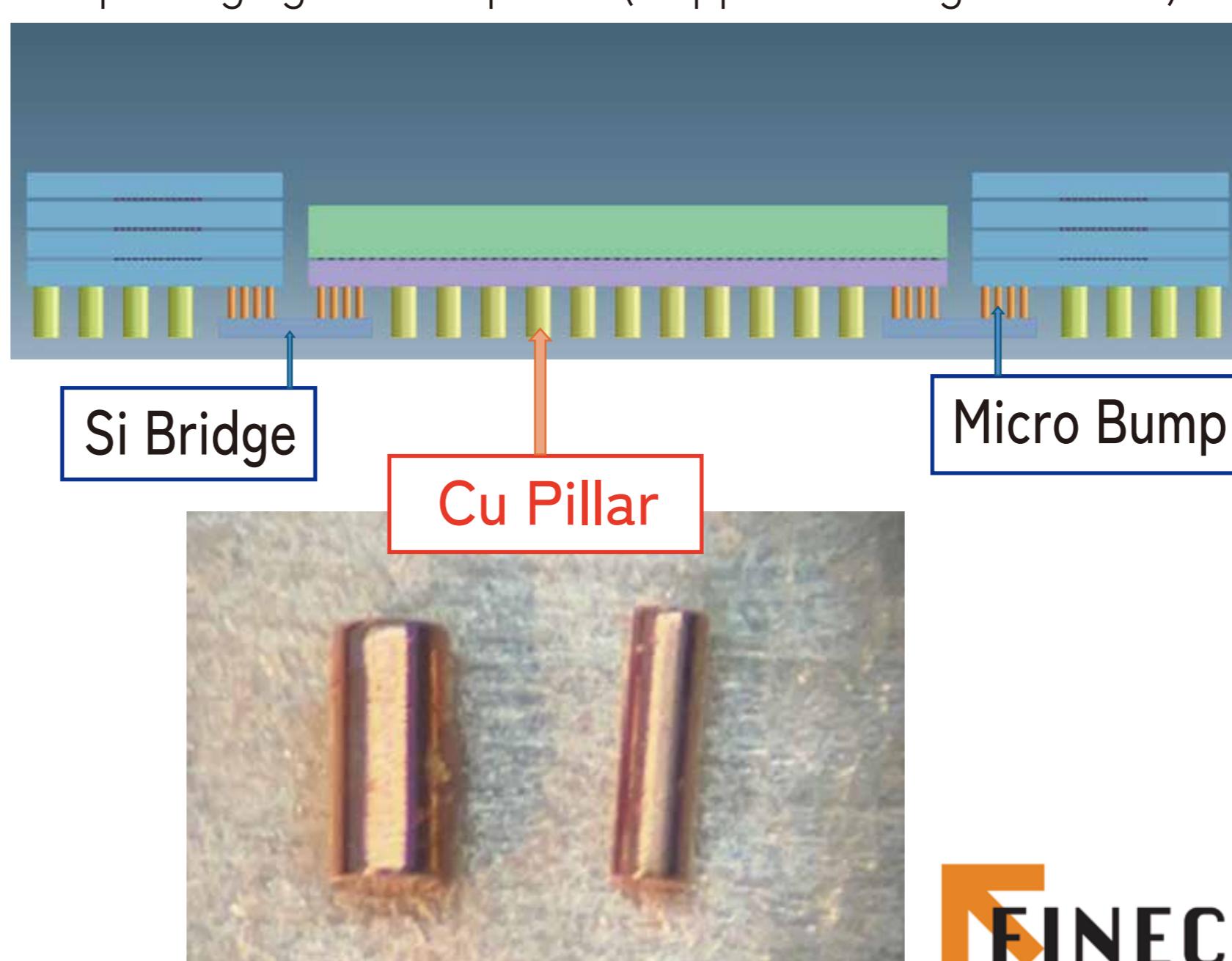
◆主な仕様 Specifications

項目 Item	仕様 Spec.
実装範囲 Mounting area	X : 44mm Y : 80mm
ピラーサイズ Pillar size	Φ : 0.3~0.5mm H : 0.6~1.0mm
プロセス Process	1 shot
搭載精度 Mount accuracy	XY : R \leq 32 μ m Tilt : R \leq 5°
サイクルタイム Cycle time	0.2 Sec

ピラーサイズΦ0.3mm 以下は
お問い合わせください。

For pillar sizes below ϕ 0.3mm,
please contact us for more information.

Cu ピラー (銅製の接合端子) による 3D 実装
3D packaging with Cu pillars (Copper bonding terminals)



2025 年 発売予定
To be released 2025

FINECS

KAIJO